

長華科技股份有限公司
長科*(每股面額1元)
(6548)

2020/05/26

大綱

- 一、面額改變與現金股息
- 二、4月20日董事會重大決議
- 三、回台投資與擴產計畫
- 四、營運績效
- 五、產業及未來展望
- 六、Q&A

一、面額改變與股息說明

面額改變：長科*(每股面額1元)

- 長科於2019年9月9日重新掛牌，由原本10元面額變更為1元，為國內第一家適用彈性面額股票制度的上櫃公司，也因此將股票名稱長科加註*變成長科*。
- 長科*在變更面額後，股本維持不變，而發行股數增加為364,131,050股，為原先股數的10倍。因此，長科*2019年第三季起的財報和股息皆以新股數作為計算基準。

• 票面改變前後，成交量變化

長科*(6548) 均量(張)	2019/8/28 為基準日	2020/3/31 為基準日	變動率
5日	71	332	368%
20日	53	500	843%
60日	30	410	1,267%
120日	28	359	1,182%
2019/9/9~2020/3/31	-	625	-

註：2019/8/28原股長科(6548)最後交易日，2019/9/9新股長科*(6548)重新掛牌。

• 面額改變前後之每股稅後淨利計算比較

單季	歸屬於母公司淨利 (百萬元)	舊股數 (36,413,105股)計算 之每股稅後淨利(元)	新股數 (364,131,050股)計算 之每股稅後淨利(元)
2020年第一季	127	3.60	0.36
2019年第四季	155	4.42	0.44
2019年第三季	184	5.20	0.52
2019年第二季	145	4.10	0.41
2019年第一季	123	3.48	0.35

股息：2019年度分派1.24元現金股息

- 長科*2020年3月18日董事會通過2019年全年每股擬配發現金股利1.24元，配息率為72%。
- 長科*去年股東會決議得每半年分配盈餘，而上半年0.34元現金股息已於2020年1月15日發放完畢。
- 董事會通過下半年每股將再配發現金股利0.9元，合計2019年現金股息為1.24元。

• 面額改變前後之每股現金股息差異比較

項目/期別	2019年 每股稅後淨利	2019年 每股現金股利
舊股數(36,413,105股)計算	17.2	12.4
新股數(364,131,050股)計算	1.72	1.24

• 2015年~2019年股利

元/年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019/H1	2019/H2
每股稅後淨利	2.66	1.97	14.62	23.60	0.76	0.96
每股股票股利	0	0	0	0	0	0
每股現金股利	3.00	1.20	11.50	17.00	0.34	0.90
每股合計股利	3.00	1.20	11.50	17.00	1.24	
股利發放率	113%	61%	79%	72%	72%	

註：2019年每股稅後淨利以及股利是以新股數364,131,050股計算。

二、4月20日董事會重大決議

- 決議案：長科*將持有之轉投資公司Ohkuchi Materials Co., Ltd. (OM) 44%股權以4.9億日圓售予住友金屬礦山株式會社 (Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. , SMM) 。
- 原由：長科在2017年9月以4.9億日圓取得49%之OM股權，隨即由長華集團負責OM之代理銷售業務與經營客戶關係。
- 考量：日本生產環境不利於導線架製造。

出售OM股權前後差異

2017/9~2020/4

- 長華集團代理銷售OM產品
- 長科認列49%之OM獲利

2020/5~

- 長科繼續服務OM客戶
- 長科向OM購買固定資產(生產機台)與無形資產(技術/專利)
- 長科陸續接收OM現有產品回台生產

三、回台投資與擴產計畫

回台投資

- 2019年9月通過經濟部『歡迎臺商回臺聯審會議』，長科規劃投資新台幣30億元於高雄楠梓廠區擴建廠房與新增設備。
- 2019年11月7日董事會通過，前期投入新台幣5億元於現有廠區興建新廠房。
- 將興建全新蝕刻生產線，積極擴產QFN產品。並購入OM廠機器設備與技術/專利等，在台量產。

擴產計畫

- 擴大台灣、中國產能，並於中國鎖定新的地點再建新廠。
- 以台灣、中國及馬來西亞為三大生產基地，聚焦中國以外、中國以及東南亞市場。
- 透過承接 O M 生產技術與 know-how，提高台灣技術能力。

四、營運績效

單季合併損益表(簡表, 季變化)

單位: NTD百萬元	2020年1Q		2019年4Q		QoQ
	金額	%	金額	%	%
營業收入淨額	2,154	100	2,442	100	(12)
營業成本	1,795	83	1,994	82	(10)
營業毛利	359	17	448	18	(20)
營業費用	182	8	227	9	(20)
營業利益	177	8	221	9	(20)
營業外收入及支出	12	1	(2) -	0	
稅前淨利	189	9	219	9	(14)
所得稅費用	59	3	59	2	0
本期淨利	130	6	160	7	(19)
淨利歸屬於本公司業主	127		156		(19)
淨利歸屬於非控制權益	3		4		(17)
每股盈餘(元)-稅後	0.36		0.44		
EBITDA	352		388		

單季合併損益表(簡表，年變化)

單位：NTD百萬元	2020年1Q		2019年1Q		YoY
	金額	%	金額	%	%
營業收入淨額	2,154	100	2,156	100	(0)
營業成本	1,795	83	1,808	84	(1)
營業毛利	359	17	348	16	3
營業費用	182	8	173	8	5
營業利益	177	8	175	8	1
營業外收入及支出	12	1	10	0	20
稅前淨利	189	9	185	9	2
所得稅費用	59	3	61	3	(3)
本期淨利	130	6	124	6	5
淨利歸屬於本公司業主	127		123		3
淨利歸屬於非控制權益	3		1		230
每股盈餘(元)-稅後	0.36		0.35		
EBITDA	352		364		

註：長科*面額已由10元變更為1元，為求比較基礎一致，故將2019年1Q每股盈餘(元)-稅後亦以新股數364,131,050股計算。

累季合併損益表(簡表)

單位：NTD百萬元	2019年		2018年		YOY
	金額	%	金額	%	%
營業收入淨額	9,320	100	9,785	100	(5)
營業成本	7,739	83	7,983	82	(3)
營業毛利	1,581	17	1,802	18	(12)
營業費用	748	8	708	7	6
營業利益	833	9	1,094	11	(24)
營業外收入及支出	66	1	112	1	(41)
稅前淨利	899	10	1,206	12	(25)
所得稅費用	280	3	354	4	(21)
本期淨利	619	7	852	9	(27)
淨利歸屬於本公司業主	607		843		(28)
淨利歸屬於非控制權益	12		9		33
每股盈餘(元)-稅後	1.72		2.36		
EBITDA	1,596		1,867		

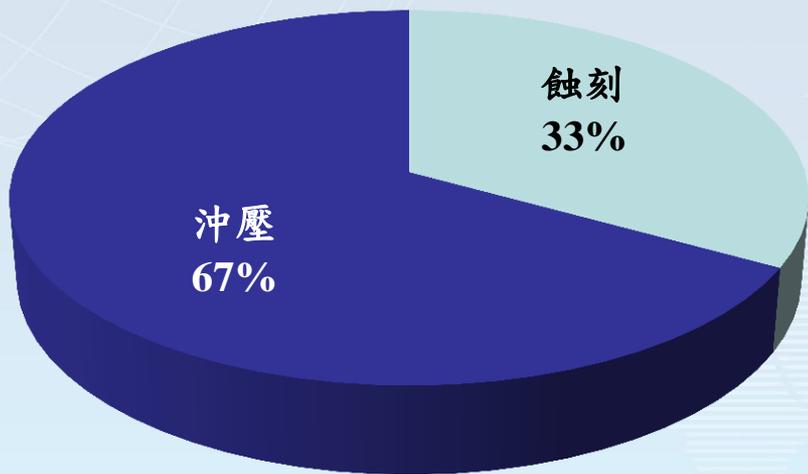
註：長科*面額已由10元變更為1元，為求比較基礎一致，故將2018年每股盈餘(元)-稅後亦以新股數364,131,050股計算。

2017~2020/1Q年合併資產負債表摘要

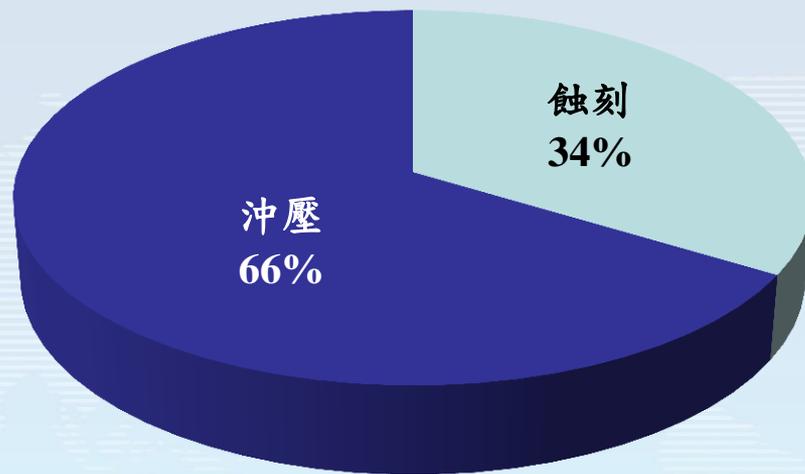
單位：NTD百萬元	2017.12.31 (IFRSs)	2018.12.31 (IFRSs)	2019.12.31 (IFRSs)	2020.03.31 (IFRSs)
現金及短期投資	2,131	2,304	3,076	3,571
應收帳款	1,816	1,925	2,002	1,711
流動資產	5,350	5,791	6,502	6,803
長期投資	146	169	174	158
流動負債	2,150	2,758	2,964	3,457
負債總計	3,970	4,617	5,558	6,130
業主權益總計	5,064	5,098	4,904	4,660
總資產	9,100	9,788	10,544	10,874
每股淨值	140.0	140.0	13.5	12.8
流動比例	249%	210%	219%	197%
負債比例	44%	47%	53%	56%

產品組合(製程別)

2018



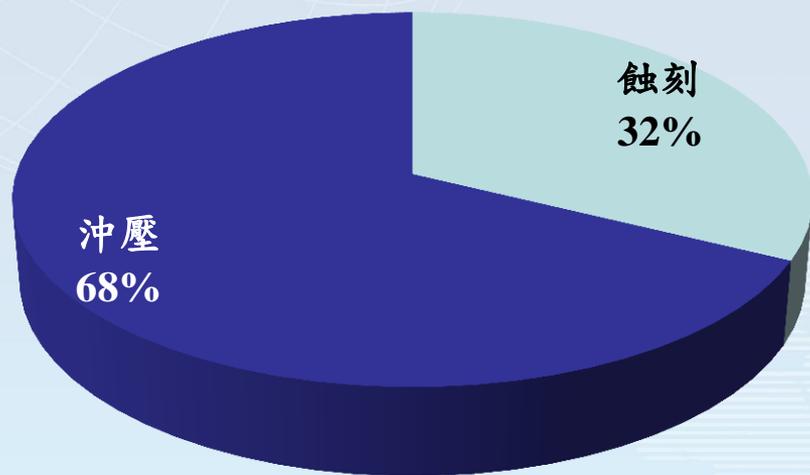
2019



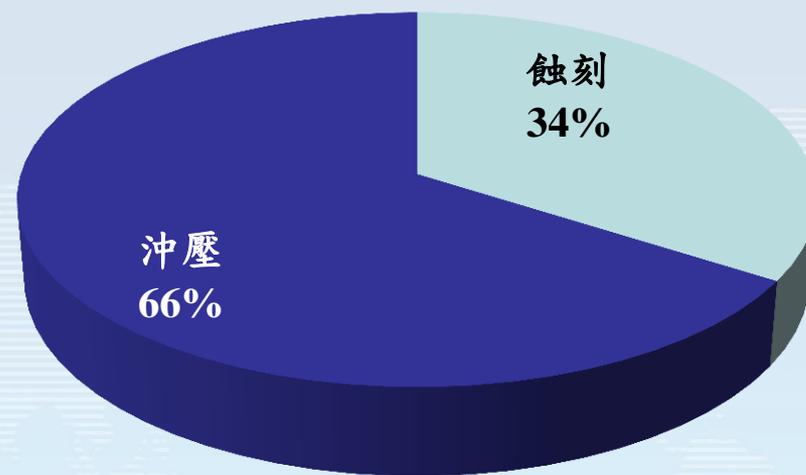
*依銷售金額(US\$)分類

產品組合(製程別)

2019 Q1



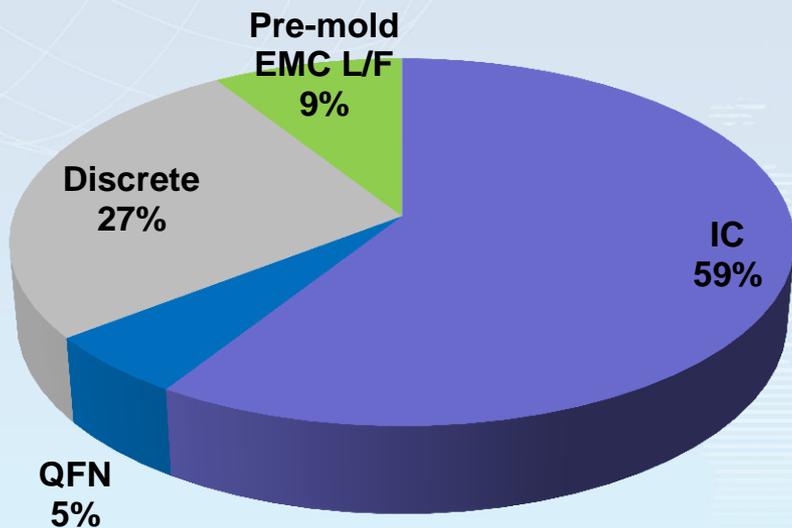
2020 Q1



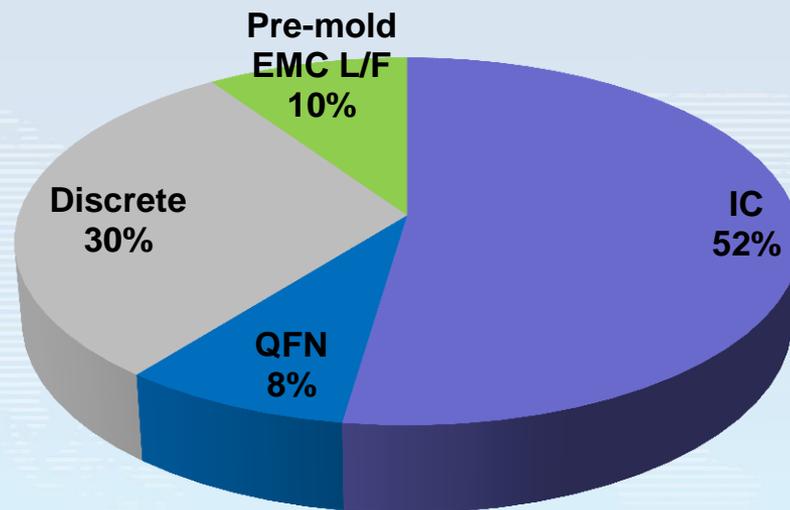
*依銷售金額(US\$)分類

產品組合(應用別)

2018



2019



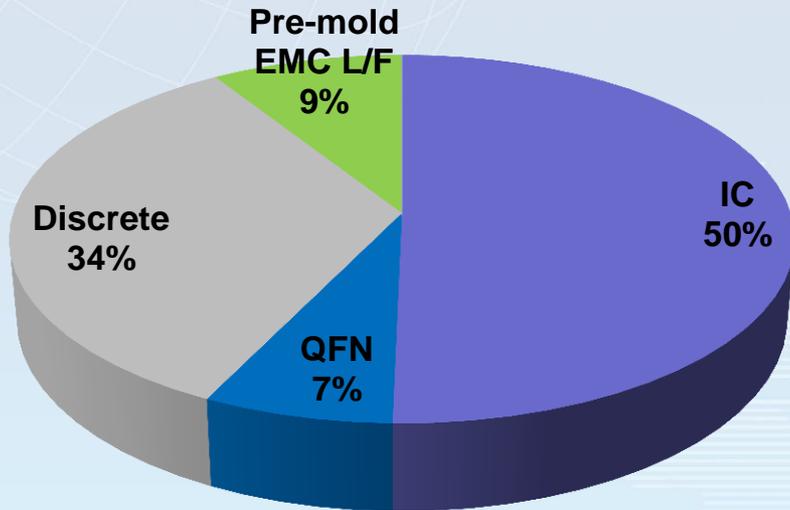
IC : SOP、TSSOP、TSOP、QFP

Discrete : SOT

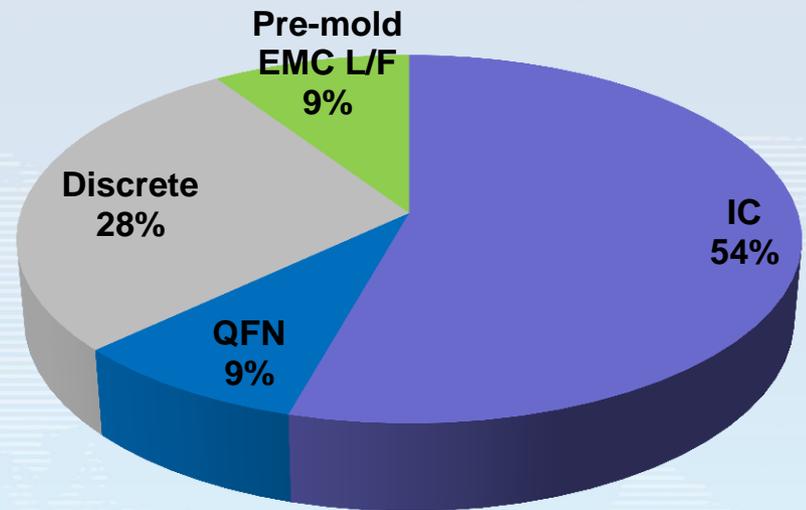
*依銷售金額(US\$)分類

產品組合(應用別)

2019 Q1



2020 Q1

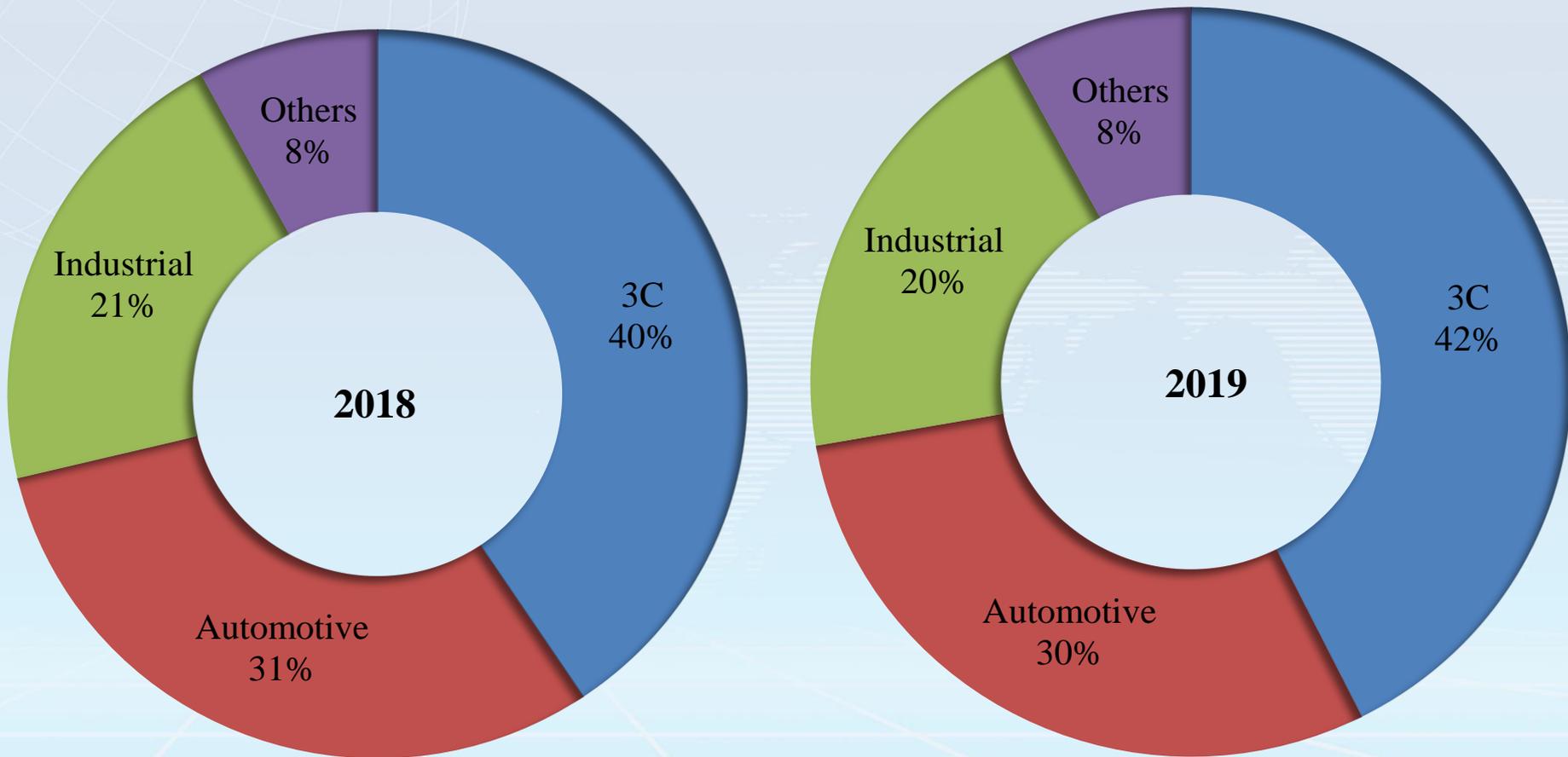


IC : SOP、TSSOP、TSOP、QFP

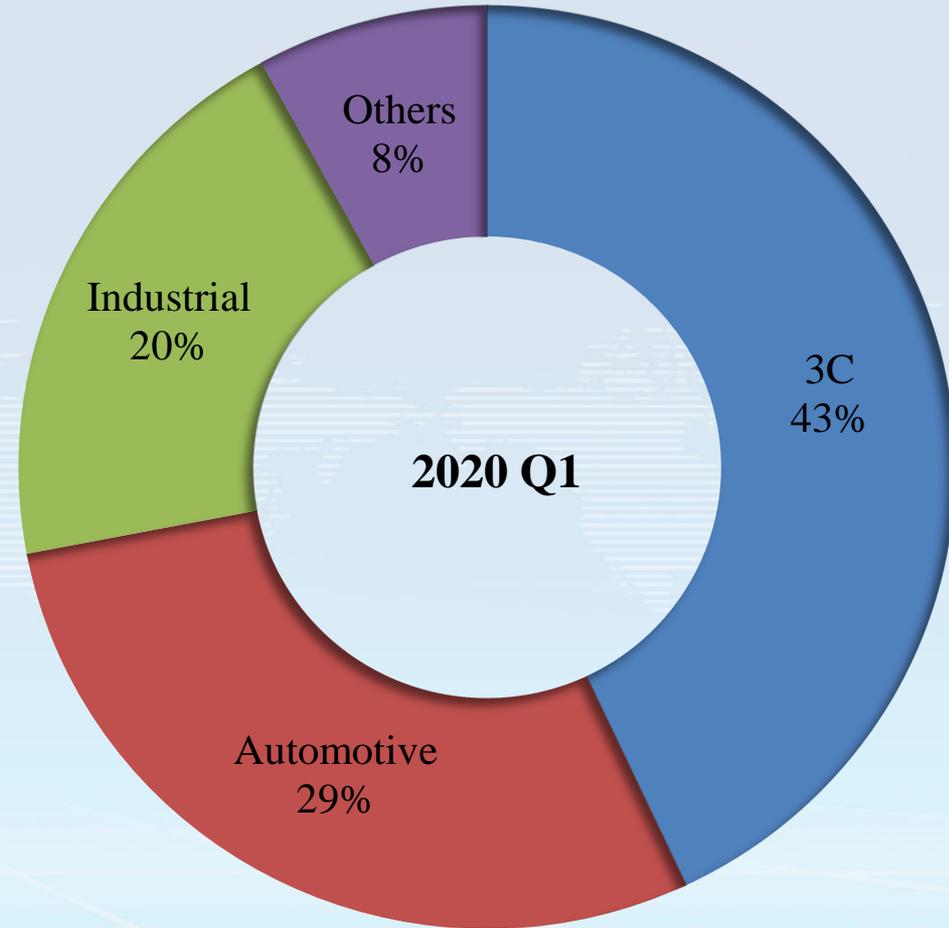
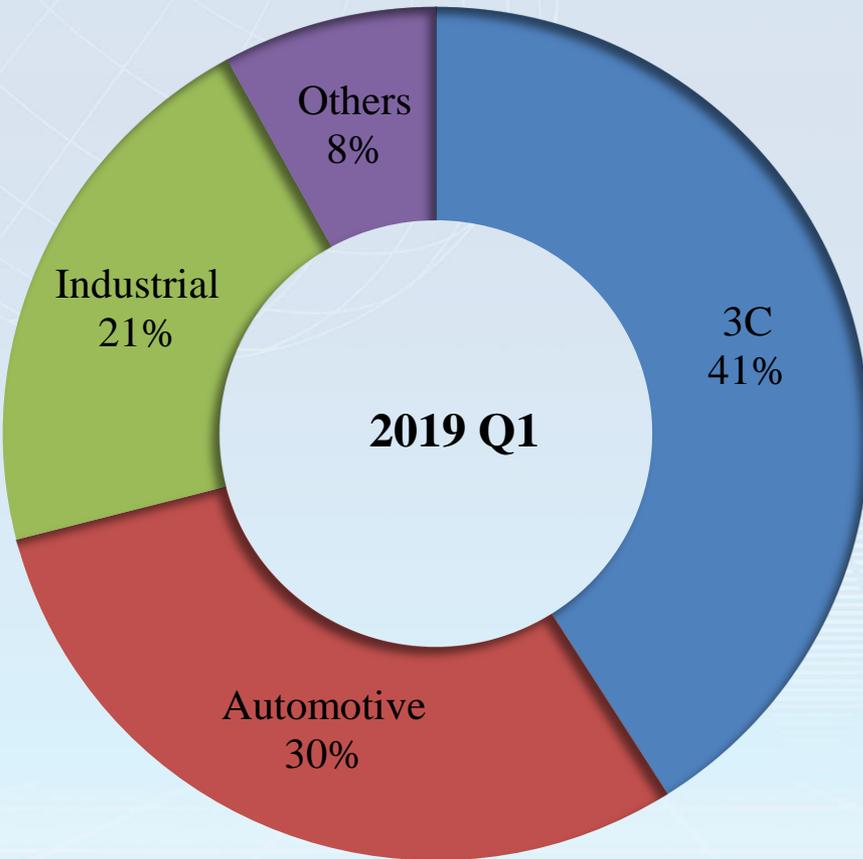
Discrete : SOT

*依銷售金額(US\$)分類

導線架下游應用別

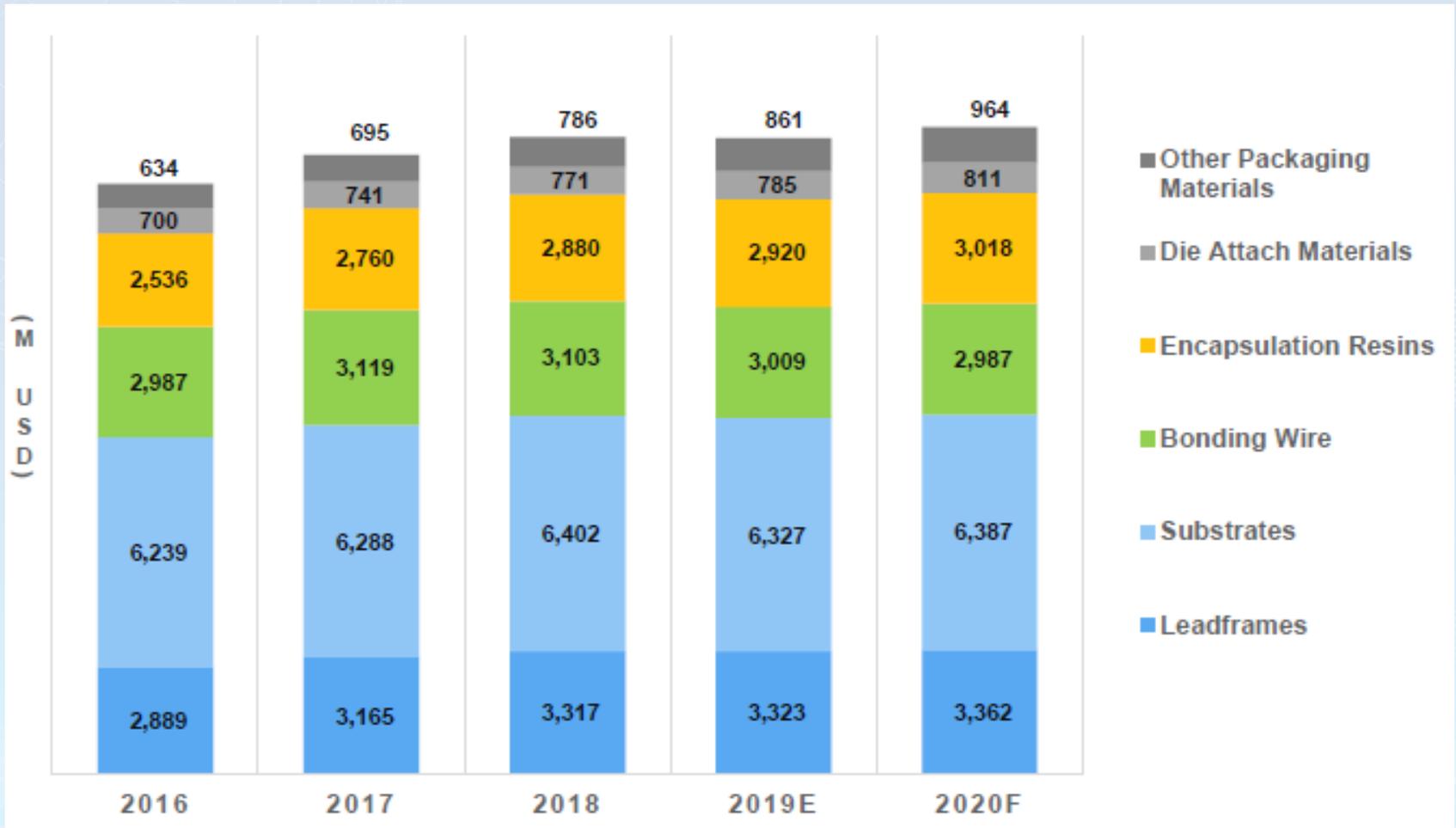


導線架下游應用別



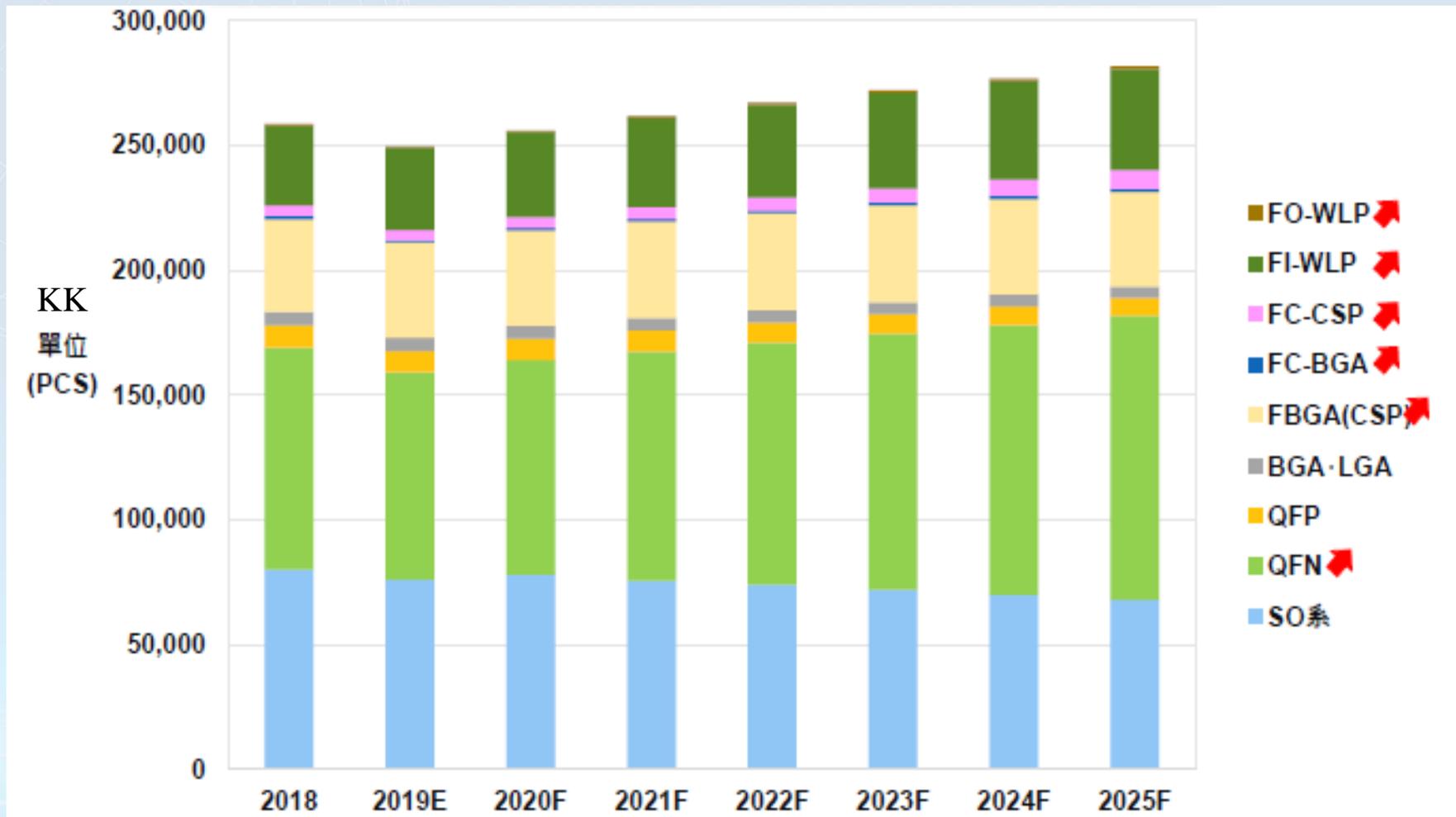
五、產業及未來展望

全球半導體封裝材料市場規模



資料來源：工研院(2019/10/29)

半導體封裝市場



資料來源：工研院(2019/10/29)

近況

- 2020年2Q：QoQ與YoY有機會正成長
- Y2020：下半年不確定性高
因為~
 - 1.油價
 - 2.疫情
 - 3.美股走勢
 - 4.第二次貿易戰

未來展望

- QFN
- 回臺擴建新廠
- 承接OM業務
- 大陸籌建新廠
- 購併機會

六、Q&A